



2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年8月3日

上場会社名 テクノクオーツ株式会社 上場取引所 東
コード番号 5217 URL <https://www.techno-q.com>
代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 園田育伸
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員管理本部長 (氏名) 麻田俊弘 (TEL) 03-5354-8171
四半期報告書提出予定日 2023年8月9日 配当支払開始予定日 —
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第1四半期の連結業績(2023年4月1日~2023年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第1四半期	4,019	△13.1	754	△24.3	806	△30.7	649	△16.9
2023年3月期第1四半期	4,627	21.1	996	17.3	1,164	42.5	782	41.4

(注) 包括利益 2024年3月期第1四半期 782百万円(△30.9%) 2023年3月期第1四半期 1,133百万円(43.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
2024年3月期第1四半期	円 銭 168.05	円 銭 —
2023年3月期第1四半期	202.31	—

(注) 当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり四半期純利益」を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
2024年3月期第1四半期	百万円 24,655	百万円 16,870	% 68.4
2023年3月期	23,792	16,590	69.7

(参考) 自己資本 2024年3月期第1四半期 16,870百万円 2023年3月期 16,590百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
2023年3月期	円 銭 —	円 銭 0.00	円 銭 —	円 銭 130.00	円 銭 130.00
2024年3月期	—	—	—	—	—
2024年3月期(予想)	—	0.00	—	115.00	115.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日~2024年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	9,310	△5.6	1,770	△14.3	1,770	△24.1	1,240	△19.1	320.68
通期	19,000	△5.3	3,660	△10.0	3,650	△16.2	2,570	△13.1	664.63

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

2024年3月期1Q	3,900,000株	2023年3月期	3,900,000株
------------	------------	----------	------------

② 期末自己株式数

2024年3月期1Q	33,286株	2023年3月期	33,286株
------------	---------	----------	---------

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

2024年3月期1Q	3,866,714株	2023年3月期1Q	3,866,955株
------------	------------	------------	------------

(注) 当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等へのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
3. 補足情報	8
(1) 生産、受注及び販売の状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症にかかる行動制限が解除されたことにより、社会経済活動の正常化が進み、景気の緩やかな回復が見られました。しかしながら、不安定な国際情勢の中、原材料やエネルギー価格の高騰、物価の上昇、為替や金融資本市場の変動等による国内景気への影響を注視する必要があり、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループが属する半導体業界におきましては、パソコンやスマートフォン向け需要の落ち込みによりメモリーを中心に在庫が滞留しており、大幅な価格低下とともに生産調整が続く状況となりました。一方で、電動化が進む自動車や再生可能エネルギー関連用途などは、引き続き需要の強さが見られます。そうした中、国内外において、先端半導体の製造工場の新設や増設など、今後を見据えた積極的な設備投資が相次いで計画・実行されており、半導体市場は底堅い潜在需要を背景として着実な拡大が見込まれております。

以上のような環境の中にあって、当社でもこの調整局面を捉えて、今後に向けた新規需要の掘り起こし、国内の増産体制構築のための準備、その他の業務改善活動を推進しながら、効率的な生産活動を展開しております。また、足元の受注は鈍化しているものの、出荷調整の動きにともない、売上高は減少していることから、高水準の受注残高は依然持続しております。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は4,019百万円（前年同期比13.1%減）、営業利益は754百万円（同24.3%減）、経常利益は806百万円（同30.7%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は649百万円（同16.9%減）となりました。

当社グループの事業は、半導体事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に記載された区分ごとの状況の分析は省略しております。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ862百万円増加し24,655百万円となりました。主な要因は現金及び預金が789百万円、棚卸資産が486百万円それぞれ増加し、売掛金が556百万円減少したこと等であります。

負債合計は前連結会計年度末に比べ582百万円増加し7,784百万円となりました。主な要因は借入金が1,454百万円増加し、買掛金が115百万円、未払法人税等が544百万円、賞与引当金が144百万円それぞれ減少したこと等であります。

純資産合計は前連結会計年度末に比べ280百万円増加し16,870百万円となりました。主な要因は利益剰余金が147百万円、為替換算調整勘定が131百万円それぞれ増加したこと等であります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,446,313	4,236,289
受取手形	5,224	11,124
電子記録債権	724,354	896,466
売掛金	4,164,470	3,608,241
製品	629,569	640,885
仕掛品	2,436,575	2,524,178
原材料及び貯蔵品	2,499,674	2,887,539
その他	443,938	354,357
貸倒引当金	△3,712	△4,353
流動資産合計	14,346,408	15,154,729
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,701,942	3,689,684
機械装置及び運搬具（純額）	3,012,909	3,199,507
土地	1,211,743	1,211,743
リース資産（純額）	178,208	172,195
建設仮勘定	547,603	430,525
その他（純額）	246,017	245,775
有形固定資産合計	8,898,425	8,949,432
無形固定資産	271,109	273,943
投資その他の資産		
その他	277,754	278,060
貸倒引当金	△868	△868
投資その他の資産合計	276,886	277,192
固定資産合計	9,446,421	9,500,568
資産合計	23,792,829	24,655,298

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
負債の部		
流動負債		
電子記録債務	556,165	484,192
買掛金	738,473	622,616
短期借入金	1,487,544	2,802,443
未払法人税等	826,577	282,445
賞与引当金	273,568	128,984
その他	676,893	599,482
流動負債合計	4,559,222	4,920,163
固定負債		
長期借入金	2,097,386	2,236,739
役員退職慰労引当金	45,044	49,447
退職給付に係る負債	175,429	191,061
その他	325,471	387,383
固定負債合計	2,643,331	2,864,630
負債合計	7,202,554	7,784,794
純資産の部		
株主資本		
資本金	829,350	829,350
資本剰余金	1,015,260	1,015,260
利益剰余金	13,691,133	13,838,244
自己株式	△40,931	△40,931
株主資本合計	15,494,812	15,641,923
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△7,331	△5,410
為替換算調整勘定	1,102,793	1,233,990
その他の包括利益累計額合計	1,095,462	1,228,579
純資産合計	16,590,275	16,870,503
負債純資産合計	23,792,829	24,655,298

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年6月30日)
売上高	4,627,397	4,019,042
売上原価	3,224,693	2,816,490
売上総利益	1,402,703	1,202,551
販売費及び一般管理費	406,657	448,147
営業利益	996,046	754,404
営業外収益		
受取利息	163	137
受取配当金	840	510
為替差益	152,034	46,555
その他	16,572	10,797
営業外収益合計	169,610	58,001
営業外費用		
支払利息	1,182	5,640
その他	1	11
営業外費用合計	1,184	5,651
経常利益	1,164,472	806,753
特別利益		
固定資産売却益	-	118
国庫補助金受贈益	-	153,230
特別利益合計	-	153,348
特別損失		
固定資産除却損	1,581	172
特別損失合計	1,581	172
税金等調整前四半期純利益	1,162,890	959,930
法人税、住民税及び事業税	295,940	232,106
法人税等調整額	84,615	78,040
法人税等合計	380,556	310,146
四半期純利益	782,334	649,783
親会社株主に帰属する四半期純利益	782,334	649,783

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
四半期純利益	782,334	649,783
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,821	1,920
為替換算調整勘定	348,175	131,196
その他の包括利益合計	350,997	133,117
四半期包括利益	1,133,331	782,900
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,133,331	782,900

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

3. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

当社グループは半導体事業の単一セグメントであります。

① 生産実績

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	4,027,995	△6.0

(注) 金額は販売価格によっております。

② 受注実績

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	4,038,772	△32.3	7,211,619	△1.7

③ 販売実績

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	4,019,042	△13.1